

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2019年1月17日(17.01.2019)



(10) 国際公開番号

WO 2019/013300 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2018/026389

(22) 国際出願日: 2018年7月12日(12.07.2018)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2017-136296 2017年7月12日(12.07.2017) JP

(71) 出願人: 株式会社新川 (SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 瀬山 耕平 (SEYAMA Kohei); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地

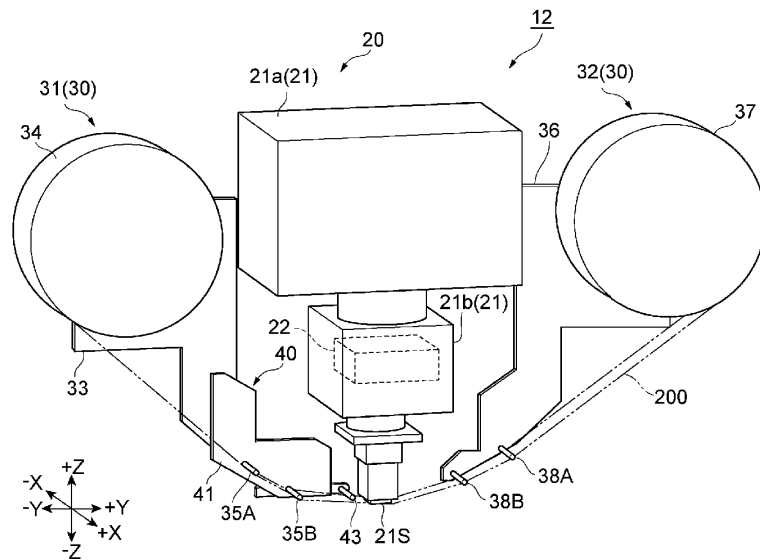
の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 野口 勇一郎 (NOGUCHI Yuichiro); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9 階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: BONDING DEVICE AND BONDING METHOD

(54) 発明の名称: ボンディング装置及びボンディング方法



(57) Abstract: This bonding device 1 is provided with: a bonding mechanism 20 which has a bonding surface 21S that holds a semiconductor die 102 in a detachable manner, with a film 200 being interposed therebetween, and a heater 22 that applies heat to the bonding surface 21S; a film conveyance mechanism 30 which supplies the film 200 to the bonding surface 21S; a remover bar 43 which is able to enter between the film 200 and the bonding surface 21S; and a drive unit 50 which drives the remover bar 43.

[続葉有]

WO 2019/013300 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: ボンディング装置 1 は、フィルム 200 を介して半導体ダイ 102 を着脱可能に保持するボンディング面 21 S と、ボンディング面 21 S に熱を提供するヒータ 22 と、を有するボンディング機構 20 と、フィルム 200 をボンディング面 21 S に供給するフィルム搬送機構 30 と、フィルム 200 とボンディング面 21 S との間に進入可能な剥がしバー 43 と、剥がしバー 43 を駆動する駆動部 50 と、を備える。